

(19) DANMARK



(12) PATENTANSØGNING<sup>(10)</sup> DK 0200/90 A

Patentdirektoratet

- 
- (21) Patentansøgning nr.: 0200/90 (51) Int. Cl. 5: C 08 L 29/04  
(22) Indleveringsdag:.... 25 jan 1990 C 08 J 5/18  
(24) Løbedag:..... 25 jan 1990 B 32 B 27/30  
(41) Alm. tilgængelig:.... 27 jul 1990  
(62) Stamansøgningsnummer:.....  
(86) International ansøgning nr.:... -  
(86) International indleveringsdag:  
(85) Videreførselsdag:  
(30) Prioritet: 26 jan 1989 US 301473  
(71) Ansøger: \*E. I. du Pont de Nemours and Company, 1007 Market Street;  
Wilmington, Delaware 19898, US  
(72) Opfinder: Richard Tieh-Hua \*Chou, 7 Hayloft Circle; Wilmington, Delaware  
19808, US  
Gedeon Imre \*Deak, 14 Ravine Road; Wilmington, Delaware 19810,  
US  
(74) Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., H.C. Andersens Boulevard 4  
, 1553, København V

- 
- (54) Blandinger af ethylenvinylalkoholcopolymer og amorft polyamid og  
flerlagsbeholdere fremstillet deraf  
(57) Sammendrag

200-90

Blandinger, der i det væsentlige består af fra ca. 50 til ca. 95 vægtprocent af en ethylenvinylalkoholcopolymer med et indhold af copolymeriseret ethylen på ca. 20 til ca. 60 molprocent og en forsæbningsgrad på mindst ca. 90%, og fra ca. 5 til ca. 50 vægtprocent af en polyamidblanding, der i det væsentlige består af fra ca. 30 til ca. 90 vægtprocent af mindst ét amorft polyamid og fra ca. 10 til ca. 70 vægtprocent af mindst ét semikrystallinsk polyamid, som er blandbart med ethylenvinylalkoholpolymeren, kan termoformes til beholdere eller andre artikler. Tilstedeværelsen af den mindre andel af amorft polyamid muliggør termoformning af ethylenvinylalkoholcopolymeren ved lavere temperaturer, uden at der opstår defekter.